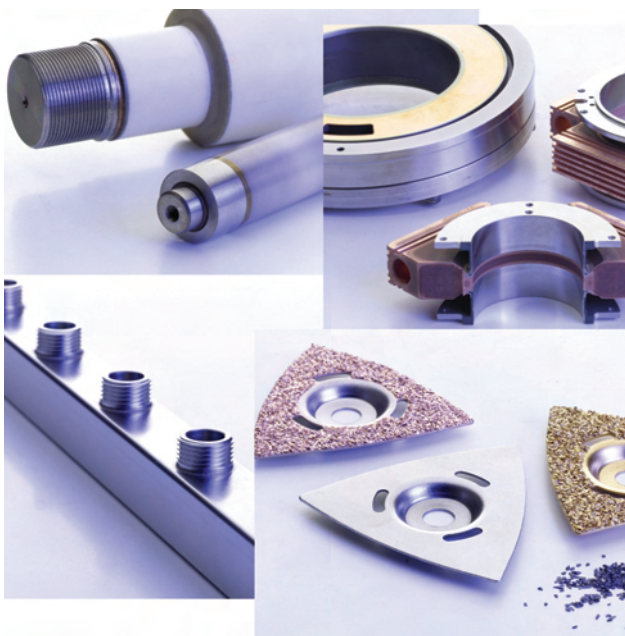


LÖT 2010

9. Internationales Kolloquium
Hart- und Hochtemperaturlöten
und Diffusionsschweißen

*9th International Conference
on Brazing, High Temperature Brazing
and Diffusion Bonding*

**Eurogress Aachen
June 15 - 17, 2010**

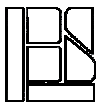


**Veranstalter:
Organizer:**

DVS

**Ideelle Mitträger:
Co-Sponsors:**

EAB3



Programm / Program

www.dvs-ev.de/loet2010

Inhaltsverzeichnis

Einladung.....	1
Sitzungen.....	2
Tabletop-Ausstellung..	3
Eröffnung.....	siehe Einhefter
Fachvorträge	siehe Einhefter
Begrüßungsabend	siehe Einhefter
Posterschau.....	siehe Einhefter
Preisverleihung.....	siehe Einhefter
Informationen	
Anmeldung	4
Zahlung / Absagen	4
Tagungsstätte.....	4
DVS-Berichte, Band 263	5
Hinweise zu den Fachvorträgen.....	5
Tagungsbüro / Registrierung	5
Teilnehmergebühren	5
Hotelreservierungen.....	6
Teilnehmerverzeichnis.....	6
Verkehrsverbindungen / Parkplätze	6
Vortragende Diskussionsleiter.....	10-12
Programmkommission	13

Table of Contents

<i>Invitation</i>	<i>1</i>
<i>Meetings.....</i>	<i>2</i>
<i>Tabletop Exhibition</i>	<i>3</i>
<i>Opening.....</i>	<i>see Insert</i>
<i>Conference Program</i>	<i>see Insert</i>
<i>Get-Together Party</i>	<i>see Insert</i>
<i>Poster Session</i>	<i>see Insert</i>
<i>Award Presentation</i>	<i>see Insert</i>
<i>Information</i>	
<i>Conference Location</i>	<i>7</i>
<i>Registration</i>	<i>7</i>
<i>Conference Desk / Check In</i>	<i>7</i>
<i>Payment / Cancellation</i>	<i>7</i>
<i>Registration Fees</i>	<i>8</i>
<i>Conference Information.....</i>	<i>8</i>
<i>Conference Proceedings.....</i>	<i>8</i>
<i>List of Attendees.....</i>	<i>8</i>
<i>Hotel Reservation.....</i>	<i>9</i>
<i>Travel Connections / Parking Area.....</i>	<i>9</i>
<i>Lecturers and Chairmen.....</i>	<i>10-12</i>
<i>Program Committee / Scientific Advisory Board.....</i>	<i>13</i>

LÖT 2010

9. Internationales Kolloquium Hart- und Hochtemperaturlöten und Diffusionsschweißen

9th International Conference on Brazing, High Temperature Brazing and Diffusion Bonding

Mit großem Erfolg wurden die bislang acht internationalen Kolloquien vom DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. durchgeführt. Wir freuen uns, alle Fachleute und Interessierten zur LÖT 2010 einzuladen, sich auf dieser herausragenden Veranstaltung mit internationalem Format über neueste Entwicklungen und Trends zu informieren und sich im internationalen Dialog auszutauschen.

Bereits heute wissen wir: LÖT 2010 wird wieder ein Highlight im Jahre 2010 sein. Wir freuen uns, Sie in Aachen zu treffen!

With great success the up to now 8 international conferences have been organized by the DVS – German Welding Society. It is a great pleasure for us inviting all specialists and interested experts to LÖT 2010 to inform about latest developments and trends and additionally to compare the latest findings in international dialogues.

Already today we know: LÖT 2010 will be a highlight in 2010. We would be pleased to see you in Aachen!

DVS

Deutscher Verband für Schweißen
und verwandte Verfahren e. V.
German Welding Society

Hauptgeschäftsführer des DVS

General Manager



Dr.-Ing. Klaus Middeldorf

Vorsitzende der
Programmkommission
Conference Chairman



Prof. Dr.-Ing. Kerstin Bobzin

June 14, 2010

17:00 - 18:00 Programmkommission LÖT 2010
Raum Tagungs-Treff

June 16, 2010

17:30 - 19:00 Mitgliederversammlung der
Fachgesellschaft Löten
Raum Tagungs-Treff

17:30 – 19:00 IIW Commission XVII “Brazing,
soldering and diffusion joining”
Conference room 2, Toledo

Sponsor der LÖT 2010 /
Sponsor of the LÖT 2010



UMICORE AG & Co. KG, Hanau, Germany

Parallel zum 9. Internationalen Kolloquium für Hart- und Hochtemperaturlöten und Diffusionsschweißen präsentieren sich folgende Firmen:

Concurrent with the 9th International Conference on Brazing, High Temperature Brazing and Diffusion Bonding the following exhibitors are presented:

Aussteller / Exhibitors

- Arbeitsgruppe W3 des DVS, Düsseldorf/DE
- eldec Schwenk Inducation GmbH, Dornstetten/DE
- EUROMAT GmbH, Aachen/DE
- Fontargen GmbH, Eisenberg/DE
- Innobraise GmbH, Esslingen/DE
- Johnson Matthey Plc., Royston/GB
- Listemann AG, Eschen/LI
- Lucas-Milhaupt Inc., Cudahy/US
- Mahler GmbH, Plochingen/DE
- PFARR Stanztechnik GmbH, Buttlar/DE
- Precision Ferrites and Ceramics Inc., Huntington Beach/US
- PVA Löt- und Werkstofftechnik GmbH, Wettenberg/DE
- Schmetz GmbH, Menden/DE
- Sulzer Metco AG (Switzerland), Wohlen/CH
- Umicore AG & Co. KG, Hanau/DE
- VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, Hanau/DE
- WESGO CERAMICS GmbH, Erlangen/DE
- Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG, Pforzheim/DE

Stand/*Status*: January 25, 2010

Tagungsstätte

Eurogress Aachen, Monheimsallee 48, 52062 Aachen, Deutschland

Anmeldung

Anmeldungen werden nur schriftlich (unter Verwendung des beigefügten Anmeldeformulars) an die Hauptgeschäftsstelle des DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V., Postfach 10 19 65, 40010 Düsseldorf, Deutschland, (Tel.: +49 (0) 211/1591-303, Fax: +49 (0) 211/1591-300), erbeten. Sie finden das Programm auch im Internet unter: www.dvs-ev.de/loet2010. Nach Eingang Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine Anmeldebestätigung/Rechnung zu. Die Teilnehmergebühr ist nach Erhalt der Rechnung (s. Zahlung) vor Veranstaltungsbeginn zu überweisen bzw. vor Ort zu zahlen. Bei Anmeldungen nach dem 25. Mai 2010 erhöht sich die Teilnehmergebühr um eine Nachmeldegebühr von EUR 50. Dies gilt auch für Anmeldungen vor Ort.

Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt.

Zahlung

Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr nach Erhalt der Rechnung auf das Konto des DVS:

- Dresdner Bank AG, Düsseldorf,
Konto-Nummer 212 60 11 00, BLZ 300 800 00
BIC-Code: DRESDEFF300
IBAN-Nr.: DE82 3008 0000 0212 6011 00

Banküberweisungsgebühren gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Stichwort auf Überweisungsformular (bitte immer angeben): LÖT 2010, Rechnungsnummer und Name des Teilnehmers. Wichtig!

Es besteht auch die Möglichkeit, per Kreditkarte:

- MasterCard
- Visa

zu zahlen.

Absagen

Stornierung der Teilnahme ist nur schriftlich möglich. Bei Absagen nach dem 25. Mai 2010 wird eine Bearbeitungsgebühr von EUR 50 berechnet.

Tagungsbüro/Registrierung

Gegen Vorlage Ihrer Anmeldebestätigung erhalten Sie Ihre Unterlagen am Tagungsbüro und (soweit bestellt) die DVS-Berichte, Band 263.

Das Tagungsbüro befindet sich im Foyer des Eurogress Aachen, (Tel: +49 (0) 241/9131-538, Fax: +49 (0) 241/9131-539) und ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

14. Juni 2010	15:00 - 17:00
15. Juni 2010	08:00 - 18:00
16. Juni 2010	07:30 - 18:00
17. Juni 2010	07:30 - 14:00

Teilnehmergebühren*

Mitglieder (ASM, AWS, BIL, DVS, EABS, IIW, NIL)	EUR 580
Nichtmitglieder	EUR 830
Ruheständler	EUR 175
Studenten	EUR 130
Diskussionsleiter, Vortragende, Posterautoren, Programmkommission (keine Co-Autoren)	EUR 310
DVS-Berichte, Band 263 (für Nichtteilnehmer der Tagung EUR 150)	EUR 106
Nachmeldegebühr (ab 26. Mai 2010)	EUR 50

*Die Teilnehmergebühr schließt die Kaffeepausengetränke, den Mittagsimbiss, den Besuch der Tabletop-Ausstellung und die Teilnahme am Begrüßungsabend ein.

Tagungskarten sind mehrwertsteuerfrei.

Der Preis für DVS-Berichte, Band 263, enthält 7% MwSt.

Hinweise zu den Fachvorträgen

Die Vortragsveranstaltung wird als **Diskussionsveranstaltung** durchgeführt. Die mit * gekennzeichneten Autoren sind die Vortragenden. Die fett hervorgehobenen Titel der Vorträge und Posterbeiträge machen deutlich, in welcher Sprache sie abgefasst sind. Die Tagungssprachen sind **Deutsch und Englisch mit Simultanübersetzung** (Kopfhörerausgabe am Tagungsbüro gegen Abgabe der Visitenkarte).

DVS-Berichte

Die Vorträge mit Bildern und Tabellen werden in den DVS-Berichten, Band 263 veröffentlicht.

Die vorbestellten DVS-Berichte erhalten Sie bei der Registrierung.

Posterschau

Während des Kolloquiums findet im Saal Berlin eine Posterschau statt. Die Originalarbeiten werden ebenfalls in den DVS-Berichten, Band 263, veröffentlicht. Die Autoren stehen während der im Programm angegebenen Zeiten für eine Diskussion an ihrer Posterwand (Posterschau) zur Verfügung. Darüber hinaus können auch weitere Zeiten mit den Autoren verabredet werden.

Teilnehmerverzeichnis

Alle bis zum 25. Mai 2010 angemeldeten Teilnehmer werden in ein Teilnehmerverzeichnis aufgenommen, das während der Tagung kostenlos erhältlich ist.

Hotelreservierungen

Hotelreservierungswünsche bitte mit beiliegendem Zimmerreservierungsantrag an:

aachen tourist service e.V.

Postfach 10 22 51

52022 Aachen

Deutschland

Tel.: +49 (0) 241/180 29-50, Fax: +49 (0) 241/180 29-53

E-Mail: incoming@aachen-tourist.de

oder online unter <http://www.aachen-congress.de/hotels/loet2010>

Parkplatzmöglichkeiten

Es besteht die Möglichkeit, in einer öffentlichen Tiefgarage direkt unter der Spielbank/Eurogress zu parken.

Gebühr: max. EUR 10/Tag

Verkehrsverbindungen

Bahn: Gute Verbindungen zwischen Köln - Aachen und Düsseldorf - Aachen.

Auto:

E 314 Antwerpen-Hasselt-Heerlen-Aachen

E 40 London-Brüssel-Lüttich-Aachen

A 4 Olpe-Köln-Aachen

A 44/46 Düsseldorf-Neuss-Aachen

Flugzeug:

Flughafen Maastricht-Aachen (NL), 41km – www.maa.nl

Flughafen Köln/Bonn, 85 km – www.koeln-bonn-airport.de

Flughafen Düsseldorf, 90 km – www.duesseldorf-international.de

Conference Location

Eurogress Aachen, Monheimsallee 48, 52062 Aachen, Germany

Registration

You are requested to register using the enclosed form which must be returned to the DVS (German Welding Society), Conference Department, P.O. Box 10 19 65, 40010 Düsseldorf, Germany, (phone +49 (0) 211/1591-302, fax +49 (0) 211/1591-300). You can find the program also in the internet: www.dvs-ev.de/loet2010. Acknowledgement of registration/invoice will be sent. The DVS reserves the right to charge a late registration fee of EUR 50 per ticket, if registration is received after May 25, 2010. This applies also to on-site registration. There is no restriction on the number of attendees.

Payment

Payment can be effected upon the receipt of the acknowledgement of registration/invoice, before the conference, of the following account of the DVS:

- Dresdner Bank AG, Düsseldorf,
Account No. 212 60 11 00, bank sorting code 300 800 00
BIC-Code: DRESDEFF300
IBAN-Nr.: DE82 3008 0000 0212 6011 00

Any banking charges which may be incurred will be borne by the attendees.

**Keyword for credit transfer (please do not forget):
LÖT 2010, no. of invoice and name of registrant**

Payment by credit card: We accept: MasterCard and Visa

Cancellation Fee

Cancellations must be in writing to the DVS. Cancellations after May 25, 2010 cost EUR 50 for handling charge.

Conference Desk and Check In

Registered attendees should check in and pick up their conference tickets and (if ordered) the conference proceedings as soon as possible at the conference desk.

The conference desk is located in the foyer of the Eurogress Aachen, (phone +49 (0) 241/9131-538, fax +49 (0) 241/9131-539). The conference desk is open from:

June 14, 2010	15:00 - 17:00
June 15, 2010	08:00 - 18:00
June 16, 2010	07:30 - 18:00
June 17, 2010	07:30 - 14:00

Registration Fees*

Members (ASM, AWS, BIL, DVS, EABS, IIW, NIL)	EUR 580
Non-Members	EUR 830
Senior Citizens	EUR 175
Students	EUR 130
Chairmen, Presenting Authors and Poster Presenters, Program Committee (no Co-Authors)	EUR 310
Conference Proceedings No. 263 (for Non-Attendees EUR 150)	EUR 106
Additional Fee (after May 25, 2010)	EUR 50

*The conference fees are incl. coffee breaks, lunch breaks, tabletop exhibition and get-together party.

Conference tickets are free of VAT.

Conference Proceedings include 7% VAT.

Conference Information

The conference will take place as a **discussion event**. The names of the lecturers are followed by an **asterisk**. The titles of lectures and poster contributions written in bold lettering indicate in which language the presentation will be given. The languages of the conference are **German and English with simultaneous interpreting** (headphones will be distributed at the conference desk on presentation of the business card).

Conference Proceedings

The conference proceedings will be published in advance with all illustrations and tables. If you ordered the conference proceedings with your registration form you will receive them at the conference desk.

Poster Session

During the conference a poster session will be held in the Berlin Saal. The contributions to the poster session will be published in the conference proceedings (volume 263 of the DVS report series). The presenters of the posters will be available for discussion at the times mentioned in the conference program. In addition, further contacts with the presenters can be arranged.

List of Attendees

All attendees having registered before May 25, 2010 will be entered into a list of attendees. This list will be distributed free of charge during the conference.

Hotel Reservation

Hotel reservations can be made by filling in the enclosed reservation form and faxing it to the aachen tourist service e.V.

P.O. Box 10 22 51

52022 Aachen, Germany

phone +49 (0) 241/180 29-50

fax +49 (0) 241/180 29-53

E-Mail: incoming@aachen-tourist.de

or online: <http://www.aachen-congress.de/hotels/loet2010>

Parking Area

There are a lot of parking spaces in the underground car park of the Casino/Eurogress.

Charges: max. EUR 10/day

Travel Connections

Train:

Good connections between Düsseldorf - Aachen and Cologne - Aachen.

Car:

E 314 Antwerpen - Hasselt - Heerlen - Aachen

E 40 London - Brüssel - Lüttich - Aachen

A 4 Olpe - Cologne - Aachen

A 44/46 Düsseldorf - Neuss - Aachen

Plane:

Airport Maastricht-Aachen (NL), 41km - www.maa.nl

Airport Köln/Bonn, 85 km - www.koeln-bonn-airport.de

Airport Düsseldorf, 90 km - www.duesseldorf-international.de

Vortragende, Diskussionsleiter / Presenting Authors, Poster Presenters, Chairmen

- B**
Batfalsky, P. Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich/DE
Bienvenu, Y. Ecole des Mines de Paris, Evry/FR
Blank-Bewersdorff, M. Hochschule Hof, Hof/DE
Bobzin, K. RWTH Aachen University, Aachen/DE
Boretius, M. Listemann AG, Eschen/LI
Brevet, A. CEA, Grenoble/FR
Broich, U. PVA Löt- und Werkstofftechnik GmbH, Wettenberg/DE
Buhl, S. Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich/CH
- C**
Campbell, S. Bellman-Melcor, LLC, Tinley Park/US
Chaumat, V. CEA, Grenoble/FR
Cossu, C. CEA Welding Laboratory, Is Sur Tille/FR
- D**
Dabbarh, S. RWTH Aachen University, Aachen/DE
Deißer, T. Kjellberg Finsterwalde Schweißtechnik und Verschleißschutzsysteme GmbH, Witten/DE
Demmler, A. FONTARGEN GmbH, Eisenberg/DE
Dumez, L. Doussard/FR
- E**
Elrefaey, A. Dortmund University, Dortmund/DE
Elsener, H. Empa, Duebendorf/CH
- F**
Fukushima, K. TOKAI University, Kanagawa-ken/JP
- G**
Grünzweig, C. Neutron Imaging and Activation Group Paul Scherr, Villigen/CH
- H**
Hartmann, T. Vacuumschmelze GmbH & Co. KG, Hanau/DE
Hartz-Behrend, K. Universität der Bundeswehr München, Neubiberg/DE
Hausner, S. Technische Universität Chemnitz, Chemnitz/DE
Holländer, U. Leibniz Universität Hannover, Garbsen/DE
Hoyer, I. Technische Universität Chemnitz, Chemnitz/DE
Hubert, D. Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung GmbH, Jena/DE
- I**
Ikeshoji, T. Tokyo Institute of Technology, Tokyo/JP
- J**
Jahn, S. Technische Universität Berlin, Berlin/DE
- K**
Kaabi, A. Ecole des Mines de Paris, Evry/FR
Kallage, P. Laser Zentrum Hannover e. V., Hannover/DE
Karfoul, M. Al-Baath University, Homs/SY

- Kawakami, H.
Keßler, M.
Kojima, H.
Kopp, N.
Krappitz, H.
Kümmel, S.
- Mie University, Tsu/JP
Technische Universität Clausthal,
Clausthal-Zellerfeld/DE
KANTO YAKIN KOGYO CO., LTD.,
Kanagawa/JP
RWTH Aachen University, Aachen/DE
Innobraze GmbH, Esslingen/DE
Technische Universität Chemnitz,
Chemnitz/DE
- L**
- Langohr, A.
Li, H.
Liu, C.
- Leibniz Universität Hannover, Witten/DE
Beijing University of Technology,
Beijing/CN
Technische Universität Dortmund,
Dortmund/DE
- M**
- Mao, W.
Matsu, K.
Miyazawa, Y.
Möhwald, K.
- Beijing Institute of Aeronautical
Materials, Beijing/CN
Tokyo Braze Co., Ltd., Tokyo/JP
Tokai University, Kanagawa-ken/JP
Leibniz Universität Hannover, Garbsen/DE
- O**
- Olowinsky, A.
Osmanda, A.
Oyama, T.
- Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
ILT, Aachen/DE
Technische Universität Dortmund,
Dortmund/DE
WESGO Metals, Morgan Technical
Ceramic, Hayward/US
- P**
- Pashkov, I.
Pejko, M.
Peng, H.
Persson, U.
Pönicke, A.
Puidokas, S.
- PBSU, Moscow/RUS
Technische Universität Dresden,
Dresden/DE
State Key Lab of Advanced Welding
Production Tech., Harbin/CN
Höganäs AB, Höganäs/SE
Fraunhofer-Institut für Keramische
Technologien und Systeme IKTS,
Dresden/DE
RWTH Aachen University, Aachen/DE
- Q**
- Qu, W.
- School of Mechanical Engineering
and Automation, Beijing/CN
- R**
- Rabinkin, A.
Reisgen, U.
Rommel, J.
- Metglas Inc., Hitachi Metals, Morris
Plains/US
RWTH Aachen University, Aachen/DE
Forschungszentrum Jülich GmbH,
Jülich/DE
- S**
- Sabelfeld, N.
Sändig, S.
- Technische Universität Berlin, Berlin/DE
Günter-Köhler-Institut für
Fügetechnik und Werkstoffprüfung
GmbH, Jena/DE

Vortragende, Diskussionsleiter / Presenting Authors, Poster Presenters, Chairmen

- Sawano, Y.
Schlegel, A.
Schlueter, S.
Tokai University, Kanagawa-ken/JP
RWTH Aachen University, Aachen/DE
Hydro Aluminium Deutschland GmbH,
Grevenbroich/DE
- Schmoor, H.
Schnee, D.
Sekulic, D.
Shapiro, A.
Sicking, R.
Umicore AG & Co. KG, Hanau/DE
Umicore AG & Co. KG, Hanau/DE
University of Kentucky, Lexington/US
Titanium Brazing, Inc., Columbus/US
Hydro Aluminium Deutschland GmbH,
Grevenbroich/DE
- Six, S.
Technische Universität Dresden,
Dresden/DE
- Stahlhut, C.
Laser Zentrum Hannover e. V.,
Hannover/DE
- Steiners, M.
Stroiczek, M.
Südmeyer, I.
RWTH Aachen University, Aachen/DE
Umicore AG & Co. KG, Hanau/DE
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH,
Eggenstein-Leopoldshafen/DE
- T**
- Tillmann, W.
Technische Universität Dortmund,
Dortmund/DE
- Triebert, A.
Fraunhofer-Institut für Keramische
Technologien und Systeme IKTS,
Dresden/DE
- V**
- Vanegas, E.
WESGO Metals, Morgan Technical
Ceramic, Hayward/US
- W**
- Weis, S.
Technische Universität Chemnitz,
Chemnitz/DE
- Wielage, B.
Technische Universität Chemnitz,
Chemnitz/DE
- Wilden, J.
Wojarski, L.
Technische Universität Berlin, Berlin/DE
Technische Universität Dortmund,
Dortmund/DE
- X**
- Xiong, H.
Beijing Institute of Aeronautical
Materials, Beijing/CN
- Y**
- Yamazaki, T.
Yan, H.
Tokyo Institute of Technology, Tokyo/JP
Wuxi RiYue Allots Materials Co., Ltd.,
Wuxi/CN
- Yan, J.
Harbin Institute of Technology, Harbin/CN
- Z**
- Zähr, J.
Technische Universität Dresden,
Dresden/DE
- Zhu, Y.
Zigerlig, B.
Beihang University, Beijing/CN
ZIGERLIG TEC GmbH, Klingnau/CH

F.-W. Bach	Garbsen/DE
P. Batfalsky	Jülich/DE
K. Bobzin	Aachen/DE
M.-H. Boretius	Eschen/LI
U. Broich	Wettenberg/DE
B. Brommer	Düsseldorf/DE
A. Demmler	Eisenberg/DE
U. Füssel	Dresden/DE
H. Krappitz	Esslingen/DE
L. Martinez†	Limbach-Oberfrohna/DE
P.-G. Meier	Kaarst/DE
K. Möhwald	Garbsen/DE
U. Reisgen	Aachen/DE
S. Sändig	Jena/DE
H. Schmoor	Hanau/DE
D. Schnee	Hanau/DE
R. Sicking	Neukirchen-Vluyn/DE
W. Tillmann	Dortmund/DE
H. van't Hoen	Wirges/DE
M. Weinreich	Düsseldorf/DE
B. Wielage	Chemnitz/DE
J. Wilden	Berlin/DE

International Scientific Advisory Board

B. Birch	Woodford/GB
S. Christy	Hartford/US
L. Dumez	Doussard/FR
W. F. Gale	Leeds/GB
L. Heikinheimo	Espoo/FI
J. E. Indacochea	Chicago/US
C. Levy	Roissy/FR
M. J. Lucas	Cincinnati/US
K. Matsu	Tokyo/JP
W. Miglietti	Manchester/US
M. Naka	Osaka/JP
T. H. North	Toronto/CA
S. Oki	Osaka/JP
T. Oyama	Hayward/US
C. Paponetti	Cleveland/US
R. L. Peasleet†	Madison Heights/US
A. Rabinkin	Morris Plains/US
P. Roberts	Congleton/GB
A. Shapiro	Colombo/US
R. W. Smith	Lansdale/US
B. Vilborg	Les Ulis/FR
M. L. Volpone	Genova/IT
E.R. Wallach	Cambridge/GB
E. Wettinck	Zwijnaarde/BE
H. Zhuang	Beijing/CN
B. Zigerlig	Klingnau/CH



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V.
Transfer und Netzwerk
Tagungsorganisation
Aachener Straße 172
40223 Düsseldorf
Deutschland

*DVS – German Welding
Society
Technological Exchange and
Network
Conference Department
Aachener Straße 172
40223 Düsseldorf
Germany*

phone +49 (0) 211/1591-302/ -303
fax +49 (0) 211/1591-300
tagungen@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de/loet2010

June 16, 2010	Saal Brüssel
Fügen von Leichtmetallen <i>Joining of light weight metals</i>	
Diskussionsleiter / Session Chairmen R. Sicking / K. Matsui	
08:00	Erfolgreiches Löten von Aluminium-Wärmeübertragungsprodukten Successful brazing of aluminum heat transfer products S. Campbell*, K. Allen
08:20	Dotierung von Aluminiumbasisloten zum flussmittelfreien Hartlöten von Aluminiumlegierungen <i>Doping of aluminum-based brazing solders for the flux-free brazing of aluminum alloys</i> C. Liu*, W. Tillmann, L. Wojarski
08:40	Gelötetes Vollaluminium-Werkstoffkonzept für HVAC&R-Anwendungen <i>Material packages for brazed aluminum solutions in HVAC&R</i> S. Schlueter*, T. Rasmussen
09:00	Niedrig schmelzende Aluminiumhartlote aus dem System Al-Si-Zn <i>Low-melting brazing solders from the Al-Si-Zn system</i> A. Langohr*, F. Bach, K. Möhwald, U. Holländer
09:20	Vergleichende Untersuchungen zum Löten von Magnesiumknet- und Magnesiumgusswerkstoffen <i>Comparative investigations into the brazing of wrought and cast magnesium materials</i> S. Muecklich, S. Kümmel*, B. Wielage
09:40	Tabletop-Ausstellung, Posterschau, Kaffeepause <i>Tabletop Exhibition, Poster Session, Coffee Break</i>

June 16, 2010	Saal Brüssel
Diffusionsschweißen <i>Diffusion bonding</i>	
Diskussionsleiter / Session Chairmen P. Batfalsky / S. Sändig	
10:00	Diffusionsschweißen von Aluminium-Werkstoffen zur Herstellung von Kühlstrukturen für den Einsatz im Ultrahochvakuum <i>Diffusion welding of aluminum materials for the manufacture of cooling structures for utilisation in the ultra-high vacuum</i> J. Remmel*, H. Straatmann, R. Schleichert, H. Hadamek, W. Behr, H. Göbbels, K. Fischer
10:20	Diffusionsvorgänge am Übergang der diffusionsgeschweißten Paarung ODS-Stahl/Aluminium Diffusion processes at the diffusion welded couple ODS steel/aluminum interface M. Karfoul*
10:40	Architekturregeln für die Montage von laminierten Miniatur-Zweiphasen-Bauteilen mittels Heißpressens und Roll-Bon-Verfahren Architectural rules for the assembly of miniature laminated two phase components by hot pressing and by roll bonding Y. Bienvenu*, A. Kaabi, D. Ryckelinc
11:00	Diffusionsbonden von hydrierten TC4-Titanlegierungen und TiAl-Legierungen Diffusion bonding of hydrogenated TC4 titanium alloys and TiAl alloys H. Peng*, F. Long
11:20	Tabletop-Ausstellung, Posterschau; anschließend Mittagspause <i>Tabletop Exhibition, Poster Session, followed by Lunch Break</i>

June 16, 2010	Saal Brüssel
Lichtbogen- und Strahllöten <i>Arc brazing and beam brazing</i>	
Diskussionsleiter / Session Chairmen J. Wilden / K. Möhwald	
13:00	Schweißen oder Löten? Die Kombination zweier etablierter Fügetechnologien macht Unmögliches möglich am Beispiel des Schweißlötens von Stahl-Aluminium-Mischverbunden <i>Welding or brazing? The combination of two established joining technologies makes the impossible possible citing the example of the weld brazing of steel-aluminum mixed composites</i> M. Steiners*, U. Reisgen, L. Stein
13:20	Löten als Schlüssel zum ressourcen- und energieeffizienten Fügen im Produktlebenszyklus <i>Brazing as a key to resource-efficient and energy-efficient joining in the product life cycle</i> S. Jahn, J. Wilden*, S. Reich, M. Denke, S. Goecke, E. Schmid
13:40	Auswirkungen von Prozessbedingungen beim Lichtbogenlöten auf die Schwingfestigkeit hochfester Stahlfeinbleche <i>Effect of process conditions during arc brazing on the fatigue strength of high-strength steel sheets</i> M. Keßler*, V. Wesling, A. Schram
14:00	Selektives Laserlöten mittels Glaslot für Hochtemperaturanwendungen <i>Selective laser brazing using glass brazing solder for high-temperature applications</i> S. Kasch, D. Hubert*, J. Kammann, H. Müller, S. Wächter
14:20	Laserstrahlbasiertes selektives Glaslöten als Fügeverfahren mit angepasstem thermischem Management <i>Laser-beam-based selective glass brazing as a joining process with adjusted thermal management</i> A. Olowinsky*, H. Kind, A. Gillner
14:40	Verifikation verschiedener Lotlegierungen für das Laserstrahllöten von umformfähigen Mischverbindungen aus Stahl und Aluminium <i>Verification of various brazing solder alloys for the laser brazing of formable mixed joints between steel and aluminum</i> P. Kallage*, H. Haferkamp, D. Kracht, D. Herzog

June 16, 2010	Saal Brüssel
15:00	Einfluss des Zusatzwerkstoffs und der Übergangstexturen auf die Scherfestigkeit von laserstrahlgelöteten Keramik-Stahl-Verbindungen Influence of filler material and interface textures on the shear strength of laser brazed ceramic-steel joints I. Südmeyer*, M. Rohde
15:20	Tabletop-Ausstellung, Posterschau, Kaffeepause <i>Tabletop Exhibition, Poster Session, Coffee Break</i>
	Grundlagen des Lötens <i>Fundamentals of brazing</i>
	Diskussionsleiter / Session Chairmen U. Füssel / A. Shapiro
16:00	Entwicklung von Eisenbasisloten zum Hochtemperaturlöten von trinkwasserkontaktierten Werkstoffen <i>Development of iron-based brazing solders for the high-temperature brazing of materials in contact with drinking water</i> I. Hoyer*, B. Wielage, S. Hausner
16:20	Einschätzung der Lötbarkeit von Cd-freiem Lötzusatzwerkstoff mittels Methode mit variierendem Spalt <i>Estimation of brazing-ability of Cd-free Ag based brazing filler metal by varying gap method</i> Y. Miyazawa*, K. Kaneko, Y. Kawai, L. Ssamouth, T. Ariga
16:40	Mikrogefüge und mechanisches Verhalten von intermetallischen Verbunden am Übergang zwischen Titan- und Aluminiumlegierungen mittels Schmelztauchens und Ultraschalllötens Microstructure and mechanical behavior of intermetallic compounds at the interface between titanium and aluminum alloys by hot-dipping and ultrasonically brazing J. Yan*, Z. Ma, W. Zhao, D. Li
17:00	Studie über die Beeinflussung der Verschiebungsmechanismen bei Fügeprozessen ohne Vakuum für Aluminium unter Verwendung von Cu-Zwischenschichten Study of displacement control in bonding process of Al vacuum free bonding by Cu insert metal H. Kawakami*, S. Ogusu, H. Ozaki, J. Suzuki
17:20	Hochtemperaturlöten von Mo/Mo-Re mit einem Nanoverbund Mo-Ni High temperature brazing of Mo/Mo-Re with a nano-composite Mo-Ni D. Sekulic*, D. Busbaher, W. Liu
17:40	Entlöten von Kupfer-Hochtemperaturlötverbindungen <i>Debrazing of high-temperature-brazed joints on copper</i> M. Blank-Bewersdorff*, R. Michael

June 17, 2010	Saal Brüssel
Fügen von Hartstoffen, Hartmetallen, Cermets <i>Joining of cemented carbides, hard metals, cermets</i>	
Diskussionsleiter / Session Chairmen H. Krappitz / L. Dumez	
08:00	Verbesserung der Fertigungsqualität von Kreissägeblättern durch diodenlasergestützte Bestückung mit Hartmetallschneiden <i>Improvement in the fabrication quality of circular saw blades by equipping them with carbide cutting edges with the aid of diode lasers</i> C. Stahlhut*, H. Brand
08:20	Einfluss der Bandbreite von Schichtloten auf die Festigkeit der Verbindung von Hartmetall und Stahl bei Sägeblättern <i>Influence of the spectrum of layered brazing solders on the strength of the joint between hard metal and steel in the case of saw blades</i> D. Schnee*, C. Zenk, M. Magin, S. Rassbach, T. Hafner, U. Meyer
08:40	Fügen eines oberflächenmodifizierten Diamanten an eine Fe-42Ni-Legierung unter Verwendung eines Zn-5Al-Lots Joining of surface modified diamond to Fe-42Ni alloy using Zn-5Al solder T. Yamazaki*, A. Suzumura, T. Ikeshoji
09:00	Untersuchung der Einflüsse unterschiedlicher Aktivlote und Lötprozessparameter auf die Fügezonenausbildung und die Eigenschaften von CVD-Diamantdickschicht-Hartmetall-Lötverbunden <i>Investigation into the influences of different active brazing solders and brazing process parameters on the joining zone formation and on the properties of the brazed composites consisting of the CVD diamond thick film and the hard metal</i> A. Osmanda*, W. Tillmann, S. Yurchenko, D. Biermann, T. Mohn
09:20	Mikrostruktur, Eigenspannungen und Scherfestigkeit von Diamant-/Stahl-Verbunden in Abhängigkeit der Lötparameter <i>Microstructure, residual stresses and shear strength of diamond-steel composites depending on the brazing parameters</i> S. Buhl*, C. Leinenbach, R. Spolenak, K. Wegener
09:40	Tabletop-Ausstellung, Posterschau, Kaffeepause <i>Tabletop Exhibition, Poster Session, Coffee Break</i>

June 17, 2010	Saal Brüssel
Modellierung und Simulation / Qualitätssicherung, Prozess- und Produktqualität <i>Modeling and simulation / Quality assurance, process quality and product quality</i>	
Diskussionsleiter / Session Chairmen B. Wielage / B. Zigerlig	
10:00	Qualitative Vorausberechnung der Benetzungsvorgänge beim Löten mittels Methoden der klassischen Molekulardynamik (MD) <i>Qualitative prior calculation of the wetting processes during brazing using classical molecular dynamics (MD) methods</i> K. Hartz-Behrend*, F. Bach, K. Möhwald, J. Prehm
10:20	Rechnergestützte Auslegung von Lötverbindungen <i>Computer-assisted design of brazed joints</i> L. Wojarski*, W. Tillmann, A. Osmanda, C. Liu, K. Bobzin, T. Schläfer, N. Kopp, S. Puidokas
10:40	Simulation der Wärmeausbreitung beim reaktiven Fügen <i>Simulation of the heat propagation during reactive joining</i> S. Jahn, J. Wilden, T. Hannach, N. Sabelfeld*
11:00	Hartlöten von Edelstahl im Schutzgasdurchlaufofen mit modifizierten Nickelbasisloten <i>Brazing of high-grade steel in the continuous furnace with a controlled atmosphere using modified nickel-based brazing solders</i> U. Holländer*, F. Bach, K. Möhwald, J. Schaup, C. Roxlau
11:20	Einmallöten von Kupfer-Messing-Heizkörpern One-shot brazing of copper-brass radiators M. Strojczek*, J. Partanen
11:40	Zerstörungsfreies Prüfen von gelöteten Komponenten bei Verwendung von mit Bor legiertem Nickellot mittels Neutronenstrahlen Non-destructive inspection of brazing and weld connections with neutron imaging methods C. Grünzweig*, E. Lehmann, M. Haller
12:00	Tabletop-Ausstellung, Posterschau, Kaffeepause <i>Tabletop Exhibition, Poster Session, Coffee Break</i>

June 17, 2010	Saal Brüssel
Industrielle Anwendung des Lötens 2 <i>Industrial application of brazing 2</i>	
Diskussionsleiter / Session Chairmen U. Broich / U. Reisgen	
12:40	Industrietaugliche Fertigungsanlage zum automatisierten Fügen und Trainieren von Presslöt-Verbindungen <i>Industrially suitable fabrication installation for the automated joining and training of pressed / pressure-brazed joints</i> M. Pejko*, U. Füssel, C. Kämmerer, D. Nguyen, B. Hommel, H. Finzel
13:00	Untersuchung der Anwendung des Hartlötens zur Herstellung innenhochdruckgefügter Bauteile <i>Stresses on the application of brazing for the manufacture of components by means of internal high-pressure joining</i> A. Demmler*, F. Gley, P. Elsenheimer, D. Vogler
13:20	Ein neuartiger „Oxion“-Ofen wurde für Metallfügeverfahren entwickelt und eingesetzt A new type of furnace "Oxion" was developed and used in metal joining processes H. Kojima*, K. Kanda, K. Watanabe, N. Sakamoto, S. Mizuguchi, S. Takahashi, M. Kawamura
13:40	Einfluss der natürlichen Aluminiumoxidschicht auf das thermische Fügen <i>Influence of the natural aluminium oxide coat on thermal joining</i> J. Zähr*, U. Füssel, H. Ullrich, M. Türpe, B. Grünenwald, A. Wald, S. Oswald

June 17, 2010	Saal Brüssel
14:00	Schlusswort mit Preisverleihung <i>Closing Remarks and Award Presentation</i>
	Der DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. hat auf Vorschlag der Programmkommission Förderpreise ausgesetzt, mit denen vier Beiträge ausgezeichnet werden. Die Auswahl der Arbeiten erfolgt durch ein neutrales Preis Komitee, dem die Mitglieder der Programmkommission angehören. <i>At the suggestion of the program committee the DVS – German Welding Society has launched a promotional scheme for the four of the best contributions. The successful contributions will be chosen by a neutral prize committee which will include members of the program committee.</i>

Posterschau / Poster Session	
Diffusionsschweißen Diffusion bonding	
1	Einfluss der metallphysikalischen Werkstoffgrößen auf die Prozessführung beim Diffusionsschweißen <i>Influence of the metal-physical material variables on the process control during diffusion welding</i> S. Jahn*, J. Wilden, V. Tkachenko
2	Diffusionsvorgänge am Übergang einer diffusionsgeschweißten Titan-/Aluminumpaarung an Umgebungs-luftatmosphäre Diffusion processes at the interface of titanium/aluminum diffusion welded pair in ambient air atmosphere M. Karfoul*
3	Entwicklung von „strukturierten“ Substraten und Weichlöten für Hochleistungselektronikmodule im Automobilbau unter Verwendung des Festkörperfügens und der Pulvermetallurgie Development of "architected" substrates and solders for automotive high power electronic modules using solid state joining and powder metallurgy A. Kaabi*, Y. Bienvenu, J. Idrac
Fügen von Glas, Keramik, Metall Joining of glass, ceramics, metals	
4	Elektrische Kontaktierung von Keramiken für Hochtemperaturanwendungen <i>Electrical contacting of ceramics for high-temperature applications</i> A. Triebert*, H. Martin, E. Zschippang, S. Apelt
5	Aktivlöten von Kupfer mit Keramik Active soldering copper with ceramics W. Qu*, Z. Zhang, H. Zhuang
6	Jüngste Entwicklungen im BraSiC®-Verfahren: Löten und Prüfung einer Siliciumcarbid-Nachbildung eines Kompaktwärmetauschers Recent developments in the BraSiC® process: brazing and testing of a silicon carbide mock-up of a compact heat exchanger A. Brevet*, V. Chaumat, O. Gillia, G. Roux, P. Tochon, F. Pra

Posterschau / Poster Session	
7	Beitrag zum Induktionslöten von Metall-Keramik <i>Contribution to the induction brazing of metal-ceramic</i> S. Hausner*, B. Wielage, I. Hoyer
8	Reactive air brazing sauerstoffleitender Keramik mit Cr-Ni-Stahl <i>Reactive air brazing of oxygen-conducting ceramic with Cr-Ni steel</i> S. Dabbarh*, E. Pfaff, C. Broeckmann
9	Entwicklung eines Glas-Silber-Lotes mit angepasstem Ausdehnungskoeffizient <i>Development of a glass-silver brazing solder with an adjusted coefficient of expansion</i> S. Dabbarh*, M. Shi, E. Pfaff, C. Broeckmann
Fügen von Hochleistungswerkstoffen Joining of high performance materials	
10	Vakuuminduktionslöten von Ti-6Al-4V und nichtrostendem Stahl mit einer Au-Ni-Legierung Vacuum induction brazing of Ti-6Al-4V and stainless steel with Au-Ni alloy C. Cossu*, E. Suzon, G. Paradis
11	Kinetik eines mit Ag-10Ti-Aktivlot gelöteten mit Kohlenstofffaser verstärkten Verbundes Kinetics of carbon fiber reinforced composite brazed by Ag-10Ti active braze W. Qu*, Z. Zhang, L. Zhang, H. Zhuang
12	Kombiniertes Induktions-Ultraschall-Löten von Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen <i>Combined induction-ultrasonic brazing of aluminum-matrix composite materials</i> S. Weis*, B. Wielage, I. Hoyer
Fügen von Leichtmetallen Joining of light weight metals	
13	Entwicklung eines NIR-Lötverfahrens für die Fertigung von Solarabsorbern aus Aluminium <i>Development of an NIR brazing process for the fabrication of solar absorbers made of aluminum</i> S. Six*, U. Füssel
14	Anwendung neuartiger Lötprozesse zum Fügen der AZ31-Magnesiumlegierung Application of novel brazing process for joining AZ31 magnesium alloy A. Elrefaey*, W. Tillmann

Posterschau / Poster Session	
15	Auswirkungen von Seltenerd-Metallen auf das Mikrogefüge und auf die Eigenschaften des Magnesium-Zusatzwerkstoffs Effects of rare earth elements on microstructure and properties of magnesium filler metal H. Li*, Z. Li, G. Li, J. Wang, C. Gao
16	Entwicklung niedrigschmelzender Al-Lote für hochfeste Al-Legierungen <i>Development of low-melting Al brazing solders for high-strength Al alloys</i> I. Hoyer*, B. Wielage, S. Weis
Grundlagen des Lötens Fundamentals of brazing	
17	Oxidationseigenschaftsanalyse am Aktivlot Oxidation property analysis on the active solder W. Qu*, Z. Zhang, H. Zhuang
18	Löten von Ti-5Al-2.5Sn- und 1Cr18Ni9Ti-Rohren mit Ag-Cu-Mn-Ni-Zusatzwerkstoff Brazing of Ti-5Al-2.5Sn and 1Cr18Ni9Ti tubes with Ag-Cu-Mn-Ni filler metal W. Qu*, Z. Zhang, H. Zhuang
19	Fügen von Titan mit nichtrostendem Stahl Joining of titanium to stainless steel Y. Sawano*, K. Fukushima, K. Matsu, Y. Miyazawa, T. Ariga
20	Auswirkung von Zusatzelementen im nichtrostendem Stahl auf die Lötbarkeit von nichtrostendem Stahl Effect of additional elements into stainless steel to brazing-ability of stainless steel Y. Miyazawa*, N. Akahoshi, N. Umeyama, T. Ariga
21	Fügen von Saphir mit Inconel Joining of sapphire to inconel K. Fukushima*, M. Akagami, M. Sekine, Y. Miyazawa, T. Ariga

Posterschau / Poster Session	
Modellierung und Simulation / Qualitätssicherung, Prozess- und Produktqualität Modeling and simulation / Quality assurance, process quality and product quality	
22	Neue Errungenschaften in der Ausbildung für das Hart- und Weichlöten New achievements in education on brazing and soldering I. Pashkov*, A. Pashkov, V. Novosadov
23	Sicherstellung der Homogenität von vakuumtauglichen Ag-Cu- und Ag-Cu-Ni-Löten Control of homogeneity for Ag-Cu, Ag-Cu-Ni vacuum grade filler metals H. Yan*
24	Analyse der Eigenspannungen einer Keramik-Metall-Verbindung mit einer Schaumzwischen-schicht aus nichtrostendem Stahl Analysis of the residual stresses of ceramics/metals joint with stainless steel foam interlayer Y. Zhu*, Z. Du, H. Bhadeshia, A. Shizardi, P. Qu, H. Kang
25	Korrosionsprüfung von Nickelbasisloten im Trinkwasser nach DIN EN 15664-1 <i>Corrosion testing of nickel-based brazing solders in drinking water according to DIN EN 15664-1</i> I. Hoyer*, B. Wielage, K. Neh

June 15, 2010		Saal Brüssel
Eröffnung / Opening		
09:00	Begrüßungsansprachen / Opening Addresses J. Jerzembeck DVS, Leiter Forschung und Technik DVS, Head of Research and Technology K. Bobzin Vorsitzende der Programmkommission Conference Chairman H. Schmoor Vorsitzender der Fachgesellschaft Löten Chairman of the Brazing and Soldering Society	
09:15	Entwicklung von Lötungen für das Hochtemperaturlöten seit der Zeit der „Frackschleifen-Generation“: zur Erinnerung an Robert L. Peaslee High temperature brazing filler metals development since the time of the „Bow-Tie generation“: In memory of Robert L. Peaslee A. Rabinkin	
10:00	Kaffeepause / Coffee Break	
Fügen von Hochleistungswerkstoffen Joining of high performance materials		
Diskussionsleiter / Session Chairmen K. Bobzin / A. Rabinkin		
10:20	Widerstandslöten von Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen <i>Resistance brazing of aluminum-matrix composite materials</i> S. Weis*, B. Wielage, I. Hoyer	
10:40	Charakterisierung niedrig schmelzender Lötfolien der für das Fügen von Titan ausgelegten Systeme Al-Mg-Si, Al-Ag-Cu und Al-Cu-Si Characterization of low-melting brazing foils of Al-Mg-Si, Al-Ag-Cu and Al-Cu-Si systems designed for joining titanium A. Shapiro*, Y. Flom	
11:00	Systematik zur Auslegung und anwendungsrelevanten Prüfung von Nickel-Basis-Lötungen <i>Systematics for the designing and application-relevant testing of nickel-based brazed joints</i> S. Puidokas*, K. Bobzin, T. Schläfer, N. Kopp, W. Tillmann, A. Osmanda, L. Wojarski	

June 15, 2010		Saal Brüssel
11:20	Löten von C/C-Verbunden und Titanlegierungen mit Einlegen einer OFHC-Kupferfolie Brazing of C/C composites and titanium alloys with inserting OFHC copper foil T. Ikeshoji*, N. Kunika, A. Suzumura, T. Yamazaki	
11:40	Vakuumlöten eines mit Kohlenstofffaser verstärkten Verbundes an ein Metall mit einem Ag-Basislot Vacuum brazing of carbon fiber reinforced composite to metal with Ag-base braze W. Qu*, Z. Zhang, L. Zhang, H. Zhuang	
12:00	Vakuumlöten der Ni ₃ Al-Basis-superlegierung IC10 mit Erstarrung in eine Richtung Vacuum brazing of directionally solidified Ni₃Al-base superalloy IC10 W. Mao*, X. Li, H. Xiong, X. Wu, B. Chen, L. Ye, Y. Zhou, Y. Cheng	
12:20	Eröffnung der Tabletop-Ausstellung und der Posterschau; anschließend Mittagspause Opening of the Tabletop Exhibition and the Poster Session followed by Lunch Break	
Industrielle Anwendung des Lötens 1 Industrial application of brazing 1		
Diskussionsleiter / Session Chairmen H. Schmoor / M. Boretius		
13:40	Eisenbasiszusatzwerkstoffe für das Hochtemperaturlöten von nichtrostendem Stahl Iron based brazing filler metals for high temperature brazing of stainless steel U. Persson*	
14:00	Amorphe Lötfolien auf Nickel-Chrom Basis zum Verlöten von nichtrostenden Stählen in Durchlauföfen Nickel-chromium-based amorphous brazing foils for continous furnace brazing of stainless steels T. Hartmann*, D. Nützel	
14:20	Mechanische Eigenschaften von Fe-Cr-Basislötzusatzwerkstoffen Mechanical properties of Fe-Cr based brazing filler metals K. Matsu*, Y. Miyazawa, T. Ariga, T. Sawada, S. Fukumoto	

June 15, 2010		Saal Brüssel
14:40	Einsatz von Cu-P-Basispulvern für großflächige Lötverbindungen Using of Cu-P based powders for large area brazing joints I. Pashkov*, A. Pashkov, I. Ahmetzianova	
15:00	Beitrag zum Auftragslöten und -schweißen von Panzerungen mit hoher Verschleißreserve <i>Contribution to the surface brazing and welding of hardfacing coats with a high wear reserve</i> T. Deißer*, F. Bach, K. Möhwald, M. Neumann	
15:20	Tabletop-Ausstellung, Posterschau, Kaffeepause Tabletop Exhibition, Poster Session, Coffee Break	
Fügen von Glas, Keramik, Metall Joining of glass, ceramics, metals		
Diskussionsleiter / Session Chairmen W. Tillmann / T. Oyama		
16:00	Konturtreue Lote zum Fügen von Keramik an Luft <i>True-to-contour brazing solders for the joining of ceramic under air</i> N. Kopp*, K. Bobzin, T. Schläfer, D. Jäger	
16:20	Reaktives Löten an Luft als Fügetechnologie für SOFC Reactive air brazing as joining technology for SOFC A. Pönicke*, J. Schilm, M. Kusnezoff, A. Michaelis	
16:40	Benetzen und Fügen von Siliciumcarbid mit einem geschmolzenen Glas an Luft Wetting and joining of silicon carbide with a molten glass under air V. Chaumat*, O. Maillart, F. Hodaj, B. Thierry	
17:00	Aktivlotentwicklung mit verschiedenen Refraktärmetallen auf Basis kommerzieller Nickellote zum Fügen von Keramik-Metall-Verbunden <i>Development of active brazing solders with various refractory metals on the basis of commercial nickel brazing solders for the joining of ceramic-metal composites</i> A. Schlegel*, K. Bobzin, T. Schläfer, N. Kopp	

June 15, 2010		Saal Brüssel
17:20	Au-Basis-Aktivlötzusatzwerkstoffe Au based active brazing filler metals T. Oyama, E. Vanegas*	
17:40	Fügen einer beheizbaren Metall-Keramik-Struktur mit eutektischem Au-Ge Lot <i>Joining of a heatable metal-ceramic structure with a eutectic Au-Ge brazing solder</i> H. Elsener*, C. Leinenbach, J. Neuenschwander, P. Wurz, D. Piazza	
18:00	Benetzbarkeit von V-aktiven Pd-Basislegierungen auf Si ₃ N ₄ -Keramik und Festigkeit einer Si ₃ N ₄ /Si ₃ N ₄ -Verbindung Wettability of Pd based V-active alloys on Si₃N₄ ceramic and strength of Si₃N₄/Si₃N₄ joint H. Xiong*, B. Chen, W. Mao, X. Li	
19:00 - 22:00 Begrüßungsabend / Get-Together Party		
Der DVS lädt alle Tagungsteilnehmer zu einem gemütlichen Abend mit Imbiss ein. <i>All participants are invited by DVS to partake of refreshments.</i>		